

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

杭州金通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，拟分别向杭州银行股份有限公司湖墅支行申请综合授信 4000 万元、宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 5000 万元、中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 5000 万元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

二、审议和表决程序

2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。上述议案的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，上述议案无需提请股东大会审议。

三、该授信的必要性以及对挂牌公司的影响

公司本次申请授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续

稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日